

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASMPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

截至二零二四年九月三十日止三個月之 二零二四年第三季度未經審核業績公布

TCB 應用於 HBM 勢頭強勁

集團財務概要：二零二四年第三季度

- * 銷售收入為港幣 33.4 億元(4.29 億美元)，按年-3.7%，按季則+0.1%
- * 新增訂單總額為港幣 31.7 億元(4.06 億美元)，按年+7.1%，按季亦+1.5%
- * 毛利率為 41.0%，按年+683 點子，按季亦+94 點子
- * 經營利潤率為 5.3%，按年+343 點子，按季亦+129 點子
- * 盈利為港幣 2,380 萬元，按年+87.0%，按季則-82.6%
- * 每股基本盈利為港幣 0.06 元，按年+50.0%，按季則-81.8%

非香港財務報告準則計量¹：

- * 經調整盈利為港幣 2,950 萬元，按年-35.0%，按季亦-78.5%
- * 經調整每股基本盈利為港幣 0.08 元，按年-27.3%，按季亦-75.8%

二零二四年第四季度銷售收入預測

- * 將介乎 3.8 億美元至 4.6 億美元之間，以其中位數計按年-3.5%，按季亦-2.0%

¹ 有關非香港財務報告準則計量之詳情，請參閱載於本公告第 10 頁至第 11 頁的「香港財務報告準則計量與非香港財務報告準則計量之對賬」。

ASMPT Limited 董事會欣然宣布集團截至二零二四年九月三十日止三個月之未經審核業績如下：

業績摘要

ASMPT Limited 及其附屬公司(「集團」或「ASMPT」)於截至二零二四年九月三十日止三個月(「二零二四年第三季度」)錄得銷售收入為港幣 33.4 億元(4.29 億美元),較二零二三年第三季度按年減少 3.7%。集團二零二四年第三季度的綜合除稅後盈利為港幣 2,380 萬元(根據非香港財務報告準則計量¹經調整為港幣 2,950 萬元),按年增加 87.0%。二零二四年第三季度的每股基本盈利為港幣 0.06 元(根據非香港財務報告準則計量¹經調整為港幣 0.08 元),而二零二三年第三季度則為港幣 0.04 元。

管理層討論及分析

二零二四年第三季度的業務回顧將由集團表現最顯著的業務亮點開始解說,接著是集團及其分部,即半導體解決方案分部(「SEMI」)及表面貼裝技術解決方案分部(「SMT」)的財務回顧。

二零二四年第三季度集團業務摘要

整體半導體行業的復蘇步伐仍然各異。一方面,包括消費者、電腦及通訊終端市場應用的周期性半導體需求(非人工智能相關)的復蘇步伐較預期緩慢。此外,汽車及工業終端市場仍然疲弱。這些趨勢繼續影響集團半導體解決方案分部的主流業務及表面貼裝技術解決方案分部的業務。

半導體解決方案分部的主流業務於本季度的新增訂單總額按季錄得增長。然而,有關業務訂單仍然較零散,其銷量不足以反映市場廣泛地復蘇。表面貼裝技術解決方案分部的整體市場仍持續疲弱,且新增訂單總額處於較低水平,儘管如此,今年該分部依然保持市場領先地位。

另一方面,對生成式人工智能的需求上升,推動來自主要人工智能參與者的大量資本性支出。人工智能的加速採用繼續推動對先進邏輯及記憶體封裝應用的需求。集團的先進封裝(「AP」)解決方案繼續因此而受惠,其新增訂單總額於本季度保持強勁,這主要受惠於熱壓焊接(「TCB」)及光子解決方案所支持。

集團獨特及廣泛的產品組合繼續是其重要的優勢。由於集團業務遵循不同的周期,先進封裝的勢頭緩減了部分主流業務疲弱的影響。

先進封裝：多個解決方案需求強勁

集團擁有業內最全面的先進封裝解決方案,為多種應用方案提供服務。受生成式人工智能及高性能計算(「HPC」)應用的高速增長推動,對集團多個先進封裝解決方案的需求強勁,一些亮點如下：

管理層討論及分析 (續)

TCB : TCB 於本季度繼續為先進封裝新增訂單總額及銷售收入作出最大的貢獻。

於邏輯領域方面，來自集團領先的整合設備製造商客戶的晶片到晶圓（「C2W」）應用的訂單勢頭持續。集團與領先晶圓代工客戶共同開發用於超微間距晶片到晶圓邏輯應用的新一代無助焊劑 TCB 的工作仍在進行中。在晶片到基底（「C2S」）應用方面，集團亦獲得主要來自其領先晶圓代工客戶的外判半導體裝嵌及測試（「OSAT」）合作夥伴的重要 TCB 訂單。集團已於本季度開始向該外判半導體裝嵌及測試客戶付運大量晶片到基底的 TCB 工具。

除了於本季度來自多個高頻寬記憶體（「HBM」）生產企業的多項 TCB 訂單外，集團亦於十月份取得重大突破，獲得一家領先的高頻寬記憶體生產企業的 TCB 大宗訂單。集團贏得訂單，是基於其獨特的 TCB 能力，能夠無縫升級至 12 層及以上的無助焊劑應用，並且可提供處理不同封裝工藝（NCF、MUF 助焊劑 / 無助焊劑）的可互換性。該項大宗訂單將於未來數季度配合客戶的 HBM3e 12 層需求的增長而付運該工具。如此可觀的發展確認了集團的 TCB 在高頻寬記憶體的領導地位，讓 ASMP 能與更廣泛的客戶合作。

光子 : 繼 TCB 之後，集團的光子及矽光子（「SiPh」）解決方案於本季度半導體解決方案分部中對先進封裝的新增訂單總額及銷售收入貢獻最大。集團市場領先的光子解決方案繼續贏得重要的訂單，這與數據中心對 800G 光學收發器的強勁需求一致。具有最佳配置精準度的矽光子解決方案亦贏得了高端光學通信相關應用的訂單。集團預期訂單的勢頭將延續。

混合式焊接（「HB」） : 集團於本季度期間向一個邏輯領域的客戶交付了首部混合式焊接工具，這標誌著一個重要里程碑。集團有信心在未來數季度贏得更多新一代混合式焊接的訂單。

集團二零二四年第三季度財務回顧

(港幣百萬元)	二零二四年 第三季度	按季	按年
新增訂單總額	3,170.2 (4.06 億美元)	+1.5%	+7.1%
銷售收入	3,344.7 (4.29 億美元)	+0.1%	-3.7%
毛利率	41.0%	+94 點子	+683 點子
經營利潤率	5.3%	+129 點子	+343 點子
經調整盈利	29.5	-78.5%	-35.0%
經調整盈利率	0.9%	-322 點子	-42 點子

於二零二四年第三季度，集團的銷售收入達到上一次發佈預測的高位數。銷售收入為 4.29 億美元，按季持平，按年則下跌 3.7%，由於半導體解決方案分部銷售收入錄得增長，而表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入則下降。

管理層討論及分析 (續)

集團的新增訂單總額繼續錄得按年增長，按季亦錄得輕微上升。在半導體解決方案分部的推動下，新增訂單總額為 4.06 億美元，按年增長 7.1%，但部分被表面貼裝技術解決方案分部的疲弱所抵消。集團於季末的未完成訂單總額約為 8.06 億美元，訂單對付運比率為 0.95。

集團的毛利率為 41.0%，按季及按年均有所改善。利潤率按年增長顯著，主要是受半導體解決方案分部所推動。

隨著毛利率改善及營運開支穩定，經營利潤率為 5.3%，按年及按季均有改善。

集團的經調整盈利為港幣 2,950 萬元，按年和按季均有所下降，主要由於外幣匯兌虧損所致。撇除外幣匯兌影響，經調整盈利按季持平而按年則上升 73%。

集團的流動資金狀況維持穩健，截至二零二四年九月三十日，集團的現金及銀行存款總合共港幣 54.7 億元，而銀行借款則為港幣 25.8 億元。

二零二四年第三季度半導體解決方案分部財務回顧

(港幣百萬元)	二零二四年 第三季度	按季	按年
新增訂單總額	1,857.0 (2.38 億美元)	+7.0%	+40.1%
銷售收入	1,790.1 (2.29 億美元)	+7.7%	+13.7%
毛利率	48.6%	+406 點子	+1,665 點子
分部盈利	141.1	+61.2%	NM
分部盈利率	7.9%	+262 點子	+1,491 點子

NM: 無意義

半導體解決方案分部佔集團二零二四年第三季度總銷售收入的百分比增加至約為 53.5%。半導體解決方案分部的銷售收入為 2.29 億美元，按季增長 7.7%，主要受到各業務單位（「BU」）的以下發展推動：

- (i) 集成電路/離散器件業務單位的銷售收入錄得按季增長，主要由主流固晶機及引線焊接機所推動。
- (ii) 光電業務單位的銷售收入亦錄得按季增長，主要來自光子的增長帶動。
- (iii) CIS 業務單位的銷售收入按季錄得下降，是由於季節性因素導致高端智能手機應用的銷售收入下跌所致。

半導體解決方案分部的新增訂單總額按季上升 7.0%至 2.38 億美元，主要受主流業務的引線焊接機及固晶機的需求所帶動，而先進封裝的新增訂單總額則保持強勁。自二零二四年第一季度以來訂單對付運比率維持在一以上。此外，自二零二三年第四季度起半導體解決方案的季度新增訂單總額繼續呈現按年增長，並於本季度按年錄得 40.1%的強勁增幅，主要受先進封裝所推動。

該分部獲得可觀的毛利率高達 48.6%，按季上升 406 點子，主要由於 TCB 產能提升帶動產能提升所致。

管理層討論及分析（續）

二零二四年第三季度 SMT 解決方案分部財務回顧

(港幣百萬元)	二零二四年 第三季度	按季	按年
新增訂單總額	1,313.2 (1.68 億美元)	-5.4%	-19.7%
銷售收入	1,554.7 (1.99 億美元)	-7.5%	-18.2%
毛利率	32.3%	-337 點子	-376 點子
分部盈利	98.4	-48.3%	-61.8%
分部盈利率	6.3%	-500 點子	-725 點子

在二零二四年第三季度，表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入及新增訂單總額持續受到其整體市場持續疲弱的不利影響。表面貼裝技術解決方案分部第三季度的銷售收入為 1.99 億美元，按季下跌 7.5%，而新增訂單總額為 1.68 億美元，按季亦下跌 5.4%。

分部毛利率為 32.3%，按季下跌 337 點子，主要受不利的產品組合及銷量影響。

AAMI 建議交易

根據二零二四年十月二十三日的公告，集團建議出售其策略合營公司 — 先進封裝材料國際有限公司（「AAMI」）中的股權予深圳至正高分子材料股份有限公司（「SOAC」），對價為深圳至正高分子材料股份有限公司將發行的新股，餘下對價以現金支付。

除集團通過完成此項交易後而獲得的即時現金流外，建議交易亦可能為 ASMPT 的股東創造額外的價值，因為集團將獲得在半導體材料領域具有進一步增長潛力的深圳至正高分子材料股份有限公司不少於 20% 的股份。

深圳至正高分子材料股份有限公司為一間於上海證券交易所上市的公司，其股份代號為 603991.SH。

前景

短期而言，集團對先進封裝的業務前景充滿信心。然而，表面貼裝技術解決方案分部的新增訂單總額正觸底待升，半導體解決方案分部主流業務的復蘇步伐則較預期緩慢。

考慮到上述因素及季節性影響，集團預期二零二四年第四季度的銷售收入將介乎於 3.8 億美元至 4.6 億美元之間，以中位數計按年下降 3.5%，按季亦下降 2.0%。

財務概要

簡明綜合損益表

	截至 二零二四年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二四年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
銷售收入	3,344,731	3,342,213	3,474,436
銷貨成本	(1,974,030)	(2,003,989)	(2,287,756)
毛利	1,370,701	1,338,224	1,186,680
其他收入	46,181	111,350	68,826
銷售及分銷費用	(371,221)	(373,708)	(387,707)
一般及行政費用	(287,736)	(294,974)	(238,574)
研究及發展支出	(533,426)	(534,472)	(494,377)
其他收益及虧損, 淨值	(118,041)	957	(25,272)
重組費用	(7,455)	(533)	(40,444)
其他支出	(9,231)	(10,915)	(16,659)
財務費用	(53,272)	(53,645)	(28,617)
合營公司業績持份	(1,224)	11,480	7,191
除稅前盈利	35,276	193,764	31,047
所得稅開支	(11,431)	(57,068)	(18,294)
本期間盈利	23,845	136,696	12,753
以下各方本期間應佔盈利(虧損):			
本公司持有人	25,908	135,054	14,626
非控股權益	(2,063)	1,642	(1,873)
	23,845	136,696	12,753
每股盈利	3		
- 基本	港幣 0.06 元	港幣 0.33 元	港幣 0.04 元
- 攤薄	港幣 0.06 元	港幣 0.33 元	港幣 0.04 元

簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至 二零二四年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二四年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
本期間盈利	23,845	136,696	12,753
其他全面收益(支出)			
<i>不會被重新分類至損益的項目:</i>			
- 其他全面收益以公平價值列賬的權益性工具投資之公平價值收益(減值)淨額	575	(125)	(319)
<i>其後可能會被重新分類至損益的項目:</i>			
- 換算海外營運公司匯兌差額			
- 附屬公司	441,305	(118,427)	(167,044)
- 合營公司	3,164	(4,348)	1,441
- 被指定對沖現金流的對沖工具之公平價值減值	(14,352)	(8,771)	(12,092)
本期間其他全面收益(支出)	430,692	(131,671)	(178,014)
本期間全面收益(支出)總額	454,537	5,025	(165,261)
以下各方本期間應佔全面收益(支出)總額：			
本公司持有人	455,338	4,093	(164,130)
非控股權益	(801)	932	(1,131)
	454,537	5,025	(165,261)

附註：

1. 主要會計政策

本財務概要乃按歷史成本基準編製，唯衍生金融工具、其他投資、其他金融資產及於各報告期期末按公平價值計量之若干金融負債除外。歷史成本一般是根據商品及服務交換代價的公平價值。

2. 分部資料

本集團有兩個（二零二三年：兩個）經營分部：開發、生產及銷售（1）半導體解決方案及（2）表面貼裝技術解決方案。他們代表由集團製造的兩個（二零二三年：兩個）主要產品系列。

本集團以可報告之經營分部分析銷售收入和業績如下：

	截至 二零二四年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二四年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
對外客戶分部銷售收入			
半導體解決方案	1,790,053	1,662,179	1,574,647
表面貼裝技術解決方案	1,554,678	1,680,034	1,899,789
	3,344,731	3,342,213	3,474,436
分部盈利			
半導體解決方案	141,141	87,534	(110,592)
表面貼裝技術解決方案	98,446	190,345	258,028
	239,587	277,879	147,436
利息收入	33,104	36,599	19,876
財務費用	(53,272)	(53,645)	(28,617)
合營公司業績持份	(1,224)	11,480	7,191
未分配其他收入	4,827	4,528	4,894
未分配外幣淨匯兌(減值)收益及外幣 遠期合約的公平價值變動	(107,686)	699	(34,123)
未分配一般及行政費用	(60,769)	(72,352)	(37,405)
未分配其他收益及虧損	(2,605)	24	8,898
重組費用	(7,455)	(533)	(40,444)
其他支出	(9,231)	(10,915)	(16,659)
除稅前盈利	35,276	193,764	31,047
分部盈利之百分比			
半導體解決方案	7.9%	5.3%	-7.0%
表面貼裝技術解決方案	6.3%	11.3%	13.6%

3. 每股盈利

本公司持有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

	截至 二零二四年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二四年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
計算每股基本及攤薄盈利之盈利 (本公司持有人應佔之 本期間盈利)	25,908	135,054	14,626
		股份數量 (以千位計)	
	截至 二零二四年 九月三十日 止三個月 (未經審核)	截至 二零二四年 六月三十日 止三個月 (未經審核)	截至 二零二三年 九月三十日 止三個月 (未經審核)
計算每股基本盈利之普通股加權 平均股數	414,167	414,295	412,143
潛在攤薄影響之股數：			
- 僱員股份獎勵計劃	1,596	905	1,711
計算每股攤薄盈利之普通股加權 平均股數	415,763	415,200	413,854

香港財務報告準則計量與非香港財務報告準則計量之對賬

就財務表現回顧，集團已提供經調整盈利及經調整每股盈利，作為集團根據香港財務報告準則呈列的綜合業績之補充。集團相信，上述額外數據能為股東及投資者提供有關集團持續經營表現的有用補充資料，有助分析及比較各期間的財務趨勢及業績。經調整盈利及經調整每股盈利不包括重組費用的影響，重組費用主要與僱員遣散費用及福利安排有關。

採用該等非香港財務報告準則計量作為分析及比較工具存在一定的局限性。故建議股東及投資者不應將其與集團根據香港財務報告準則所呈報的財務業績分開考慮或視作替代分析。此外，該等非香港財務報告準則計量的定義可能有別於其他公司使用的類似詞彙。

下表載列集團根據香港財務報告準則編製的二零二四年第三季度、二零二四年第二季度及二零二三年第三季度財務計量與非香港財務報告準則計量的對賬。

截至二零二四年九月三十日止三個月 非香港財務報告準則調整

	賬列 港幣千元 (未經審核)	重組費用 港幣千元 (未經審核)	所得稅之影響 港幣千元 (未經審核)	經調整 港幣千元 (未經審核)
本期間盈利	23,845	7,455	(1,776)	29,524
盈利率	0.7%			0.9%
本公司持有人應佔盈利	25,908	7,455	(1,776)	31,587
每股基本盈利(港幣元)	0.06			0.08

截至二零二四年六月三十日止三個月 非香港財務報告準則調整

	賬列 港幣千元 (未經審核)	重組費用 港幣千元 (未經審核)	所得稅之影響 港幣千元 (未經審核)	經調整 港幣千元 (未經審核)
本期間盈利	136,696	533	(101)	137,128
盈利率	4.1%			4.1%
本公司持有人應佔盈利	135,054	533	(101)	135,486
每股基本盈利(港幣元)	0.33			0.33

香港財務報告準則計量與非香港財務報告準則計量之對賬 (續)

截至二零二三年九月三十日止三個月
非香港財務報告準則調整

	賬列 港幣千元 (未經審核)	重組費用 港幣千元 (未經審核)	所得稅之影響 港幣千元 (未經審核)	經調整 港幣千元 (未經審核)
本期間盈利	12,753	40,444	(7,785)	45,412
盈利率	0.4%			1.3%
本公司持有人應佔盈利	14,626	40,444	(7,785)	47,285
每股基本盈利(港幣元)	0.04			0.11

財務報表審閱

審核委員會已審閱集團截至二零二四年九月三十日止三個月期間未經審核的簡明綜合財務報表。

盈利預測

於二零二四年十月十四日，ASMPT 根據香港公司收購及合併守則（「守則」）規則 3.7 發布一份可能提出要約公告（「規則 3.7 公告」）。由於本公告乃於規則 3.7 公告後所作出，因此，就守則而言，本公告屬於要約期內發布，本公告所載的未經審核損益數字被視為守則規則 10 下的盈利預測，並須由 ASMPT 的核數師或會計師以及 ASMPT 的財務顧問就有關預測作出報告，並將有關報告納入本公告。同時，本公告亦應包含一項聲明，指出盈利預測已根據守則作出報告，且有關報告已遞交予證券及期貨事務監察委員會企業融資部之執行董事（「執行董事」）。

由於要約期最近才於二零二四年十月十四日生效，ASMPT 的核數師及財務顧問需要額外時間完成工作並發布報告。ASMPT 預計，有關報告將於二零二四年十一月十一日或者之前，於 ASMPT 發出的進一步公告中公布。因此，ASMPT 謹請 ASMPT 的股東及潛在投資者垂注，本公告並不符合守則規則 10 所規定的標準，亦未按該規則作出報告。ASMPT 的股東及潛在投資者在依賴相關盈利預測、評估根據規則 3.7 公告可能進行的任何交易之利弊及買賣 ASMPT 證券時務請審慎行事。

董事會

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐（主席）、樂錦壯先生、黃漢儀先生、鄧冠雄先生、張仰學先生及蕭潔雲女士；非執行董事：Hichem M'Saad 博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

承董事會命
董事
黃梓達

香港，二零二四年十月二十九日

ASMPT 的董事對本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據其所知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行發表。本公告並無遺漏其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導。

（本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。）